シールドソフトパッキング

Flame-retardant Shield Soft Packing

SSP-N series

Features





途

- 筐体のグラウンディング&シールディング。
- ▶ I/O パネル部のシールディング。
- D-sub コネクターのシールディング。
- パソコン、ノートパソコン、携帯電話、カーナビ等のシー ルディング。

※使用上の注意として、両面を圧接取り付けするだけの使用として下さい。

Chassis grounding and shielding.

Shielding of I/O panels.

品番表

Shielding of D-sub connectors.

Shielding of desktop computers, laptops, cell phones, and car navigation systems. * Fit the gasket simply by pressing on both sides.

		[単位 Unit:mm]			
品 番 Product code	厚 み Thickness	定 尺 Fixed sizes			
SSP-010N	1.4±0.2	300×500			
SSP-020N	2.1±0.3	300×500			
SSP-030N	3.1±0.3	300×500			

※ご要望の形状による切断、打ち抜き、ハーフカット加工品での納入となります。
* Gaskets are cut off, die-cut, or kiss-cut into the desired shape before shipment.

造

トリコット(天竺) 無電解メッキ(Cu+Ni) Tricot (warp-knitted fabric) Electroless plating (Cu + Ni) ウレタンフォーム Polyurethane foam 無電解メッキ(Cu + Ni) Electroless plating (Cu + Ni) 不織布 無電解メッキ(Cu + Ni) Nonwoven fabric Electroless plating (Cu + Ni) アクリル系粘着材 (ストライプ状) Acrylic adhesive (striped) 剥離紙 Release paper

- ▶ ウレタンフォームの連泡孔からベースの不織布及び上面 トリコット(天竺)まで無電解メッキがされているので 非常に高いシールド特性を発揮します。
- ベース裏面の粘着剤がストライプ状に加工されているの で導通損失がありません。
- ▶ 圧縮して使用すると最良のシールド効果が得られます。 筐体の合わせ目、ハウジングの合わせ目のシールディン グに最適です。
- ▶ 任意の形状に切断、打抜き、ハーフカットの加工が容易 にできます。

The SSP-N series provides effective shielding due to an electroless plating applied to the open cells of polyurethane foam, a nonwoven base fabric, and tricot (warp-knitted fabric) on the top.

The adhesive on the rear of the base fabric is applied in a striped pattern to prevent conduction losses

Shielding effects are maximized when the gasket is compressed. The gasket is ideal for shielding joints in a chassis or housing.

Gaskets are easily cut off, die-cut, or kiss-cut into various desired shapes.

シールド効果 Shielding effect

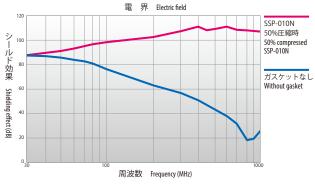
[測定方法]

50mm×70mm の開口部外周に試験サンプル(高さ 1mm/幅 10mm)を貼り付け、サ ンプル高さ50%圧縮で開口部に蓋をする。

その際、試験サンプル(0.5mm の隙間)から漏れる電磁波を KEC 法で測定し、試験 サンプルを取り付けない場合と効果を比較する。

Attach a test sample (1 mm high and 10 mm wide) around the outside edge of a 50 mm x 70 mm opening. Compress the sample until the height is reduced 50% and place the lid over the opening.

Measure electromagnetic waves leaking from the test sample (through the 0.5 mm space) by the KEC method. Compare measurement results with and without the test sample.



本データは、KEC 法 で測定した結果です The above data are measurements made by the KEC method.

符 性 Physical properties						
項 目 Item		単位 Unit	SSP-010N	SSP-020N	SSP-030N	
接触抵抗値 (ontact resistance	荷重 Load: 30 g/mm²	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.01	0.01	0.01
表面抵抗值 Surface resistance		初期 Initial	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.1	0.1	0.1
		60℃95% 100H	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.11	0.11	0.11
		60℃95% 300H	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.13	0.13	0.13
		室温放置 12 ケ月 Left to stand for 12 months at room temperature	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.1	0.1	0.1
乾熱耐久性 Dry-heat resistance	表面抵抗值 Surface resistance	80°C 1,000H	$\Omega/10\text{cm}^2$	0.13	0.13	0.13
	圧縮強さ Compressive strength	80°C 1,000H	-	0	0	0
	外観目視 Appearance	80°C 1,000H	-	0	0	0
圧縮繰り返し Repeated compression		500g ローラを 250 ストローク 250 strokes with 500 g roller	$\Omega/5 \times 4 cm^2$	0.15	0.15	0.15

⁽注) この数値は実測値で保証値ではありません。 * The values are not guranteed.

TKK TAKEUCHI INDUSTRY Co.,Ltd